

2016年7月7日

国産の熱流体シミュレーションツールを提供し続けるソフトウェアクレイドルが
基板専用熱解析ソフトウェア「PICLS® (ピクルス)」新バージョンV2を7月7日リリース！
旧バージョン (V1) はPICLS® Liteとして無償提供

株式会社ソフトウェアクレイドル (本社：大阪市北区、代表取締役社長：久芳 将之、以下ソフトウェアクレイドル) は、基板設計専用の熱解析ソフトウェア PICLS® (ピクルス) の新バージョンを下記の通りリリースいたします。

- ソフトウェア名： PICLS® (ピクルス) V2
- 価 格： 198,000 円 (税別)
※V2 有償版 1年契約、バージョンアップ料、技術サポート料含む
- ライセンス方式： フローティング (国内使用拠点数無制限)
- 発 売 日： 2016年7月7日 (木)



V2 リリースに加え、従来版 V1 を PICLS Lite として無償提供します

ソフトウェアクレイドルは 30 年以上に渡り、国産の科学技術計算ソフトウェア (熱流体解析ツール：CFD) を開発、販売し続けております。この長年蓄積したノウハウを基に、この度基板設計に特化することで、設計者自らでも熱解析をすることができるシンプルかつ低価格なソフトウェアを開発しました。

また今回は約 1 年前にリリースしました V1 をご使用いただいているユーザー様やモニター使用いただいた方々からの声を基に、より多くの機能を搭載した V2 を発売いたします。V2 のリリースに伴いまして、V1 の機能は「PICLS Lite」として無償でダウンロードいただけるフリーソフトに生まれ変わります。いずれも PICLS 専用 Web サイト (<http://www.cradle.co.jp/picls/>) よりオンラインにてソフトウェアのダウンロード・V2 のご購入手続きが行えます。

- PICLS (ピクルス) とは？

PICLS はお客様の声から生まれたこれまでにない「簡単な操作」、「リアルタイム計算」が特徴の CAE ソフトウェアです。電気・電子機器の熱対策においては、これまで機構設計時で行うことは多くありましたが、高密度化・小型化に伴い、基板設計時でも熱対策を行う必要性が急速に高まっています。弊社でも製品開発のフロントローディング化の為に基板設計時での熱対策が必要と考え、昨年 7 月、基板設計者が簡単に使える「PICLS V1」をリリースし、多くの反響を呼びました。そしてこのたび、基板設計者が必要な機能をより強化し誕生した新バージョンが「PICLS V2」です。

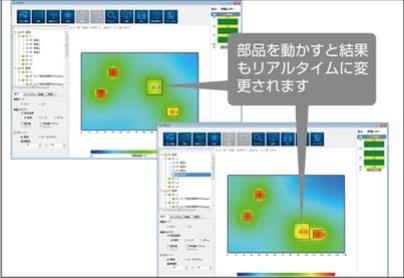
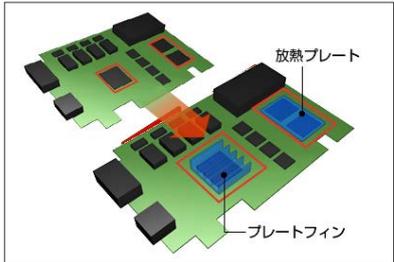
- PICLS のコンセプト

基板設計者専用の熱解析ツールとして、「2次元操作による簡単なモデル作成」「ストレスのないスムーズな結果表示」「設計アイデアを一瞬で計算するリアルタイム計算」をコンセプトとしています。また、従来からの「CAE は高価、敷居が高い」というイメージから「手軽に始められる CAE」を目指したソフトウェアです。

Head Office: 3-4-5, Umeda, Kita-ku Osaka 530-0001 Japan
TEL: 06-6343-5641 FAX: 06-6343-5580

Tokyo Office: 1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku Tokyo 141-0032 Japan
TEL: 03-5435-5641 FAX: 03-5435-5645

● 従来版 (V1) と新バージョン (V2) の主な機能

従来版 (V1) の機能	新バージョン (V2) 新機能
<ol style="list-style-type: none"> 1. マウสดラッグによる部品移動 2. 配線パターン (残銅率) のエリア指定 3. サーマルビアの設置 4. 基板の作成・切り抜き 5. 層数、銅箔厚の検討 6. 自然空冷、強制空冷の考慮 7. 輻射熱の考慮 8. ワンクリックレポート出力 9. リアルタイム熱分布表示  <ol style="list-style-type: none"> 10. 3D プレビュー 11. 流体解析ツール (STREAM、熱設計 PAC) 用のデータエクスポート 12. 熱流束ベクトル表示 (熱の流れの可視化) 	<p style="text-align: center;">V1 のすべての機能に加え下記の新機能が追加されます</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 外部ファイルインターフェース <ul style="list-style-type: none"> ・ IDF ファイルのインポート、エクスポートに対応 ・ 配線データ (Gerber データ) のインポートに対応 これにより、既存の設計データ (CAD データ) を有効利用できるため、既存製品の評価・改良が可能となります。 2. 簡易筐体への放熱を考慮 <ul style="list-style-type: none"> ・ 製品筐体と基板、製品筐体と発熱デバイスを接続することで基板上だけでなく、基板外への放熱経路の検討が可能となります。 3. 放熱プレート部品の作成、ヒートシンクの改良 <ul style="list-style-type: none"> ・ V1 で搭載されていたヒートシンク冷却機能は、単一の発熱デバイスしか冷却できませんでしたが、V2 からは複数デバイスにまたがった冷却が可能となります。  4. ライブラリ <ul style="list-style-type: none"> ・ PICLS で作成・設定した部品をライブラリに登録することが可能となります。これにより何度も同じ設定をする必要がなく、グループ内でのデータの共有など、業務効率化が図れます。 <p style="text-align: center;">※V2 の新機能については、リリース後の修正モジュールとして追加提供予定のものを含みます。</p>

● 今後のロードマップ

- ElectronicPartsMaker (<http://www.cradle.co.jp/epm/>) から出力されたデータのインポート
- HeatPathView (<http://www.cradle.co.jp/products/utility.html#hpv>) 用データの出力

【お問い合わせ】

本プレスリリースに関するお問い合わせは下記まで

株式会社ソフトウェアクレイドル 営業部 奥田・平田

Email: info@cradle.co.jp

Tel : 03-5435-5641